

智能仪表

整机动向

- 高功能化通信
→ 双向通信
- 可将高功能通信基板换装至自动检针仪表中
→ 升级

电源电路的动向

- 负荷电流的增加

- ① 高速处理
- ② 低温时的高可靠性 (-40 · C)

电容器 要求规格

低ESR

大容量

低外形

推荐商品特长

SP-Cap

- 超低ESR (3mΩ ~)
- 大容量 (~ 560uF)
- 低外形 (1.0mm ~)

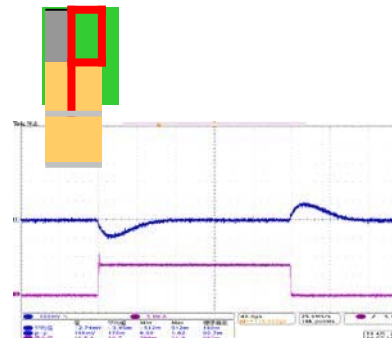
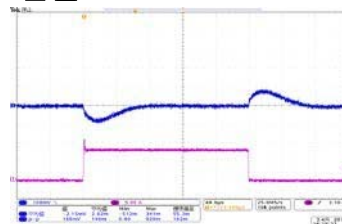
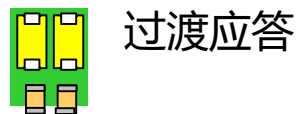


POSCAP

- 低ESR (5mΩ ~)
- 小型化 (3528)
- 低外形 (1.1mm ~)



小型/高性能



- 数量减少 (示例) : 2个 ⇒ 1个 (SP-Cap/POSCAP)
- 性能同等 + 成本削减 + 空间削减